

Title (en)

Electromagnetic component, a relay in particular, and method of sealing it.

Title (de)

Elektromagnetisches Bauelement, insbesondere Relais, und Verfahren zu dessen Abdichtung.

Title (fr)

Composant électromagnétique, en particulier relais et méthode pour le rendre étanche.

Publication

EP 0223112 A1 19870527 (DE)

Application

EP 86114900 A 19861027

Priority

DE 3538621 A 19851030

Abstract (en)

[origin: US4713727A] The component comprises a base body which has the contours of a cuboid housing. For the purpose of sealing, a foil is placed over the open lateral faces of the base body, whereby individual function chambers are separated from one another by corresponding seating surfaces of the housing and the foil. In this way, for example, the coil chamber can be filled with casting compound without having this casting compound run into the switch chamber. The foil thus eliminates an additional housing which would require more work steps and a higher volume of space to be occupied by the component.

Abstract (de)

Das Bauelement besitzt einen Grundkörper (1), der die Konturen eines quaderförmigen Gehäuses aufweist. Zur Abdichtung wird eine Folie (9) über die offenen Seitenflächen des Grundkörpers gelegt, wobei einzelne Funktionskammern (5; 11) durch entsprechende Auflageflächen (13, 14, 15) des Gehäuses und der Folie voneinander getrennt werden. Auf diese Weise kann beispielsweise ein Spulenraum mit Vergußmasse gefüllt werden, ohne daß diese Vergußmasse in den Schaltraum (5) hineinläuft. Die Folie erspart damit ein zusätzliches Gehäuse, welches mehr Arbeitsgänge und mehr Volumen benötigen würde.

IPC 1-7

H01H 50/02

IPC 8 full level

H01H 49/00 (2006.01); **H01H 50/02** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01H 50/023 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] US 3756399 A 19730904 - COSIER R, et al
- [A] EP 0129068 B1 19870415
- [AD] DE 2901077 A1 19800717 - SIEMENS AG
- [A] DE 2520169 A1 19761118 - SIEMENS AG
- [A] DE 2535173 A1 19770224 - SIEMENS AG [DE]

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0223112 A1 19870527; JP S62105330 A 19870515; US 4713727 A 19871215

DOCDB simple family (application)

EP 86114900 A 19861027; JP 25708286 A 19861030; US 92072186 A 19861020